

# 大電流対応厚銅基板

## Heavy Copper PWB

### 特長 Features

- 大電流ユニットに対応  
Correspondence to Large Current unit
- 銅厚: 175 $\mu\text{m}$ ~500 $\mu\text{m}$   
Copper Thickness: 175 $\mu\text{m}$ ~500 $\mu\text{m}$   
※内層210 $\mu\text{m}$ 以上(開発中)

### 用途 Application

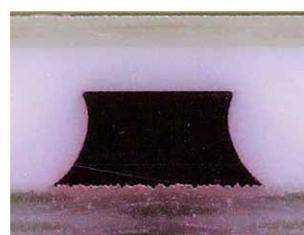
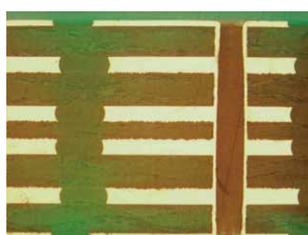
- ジャンクションボックス
- 電源モジュール
- 充電器
- インバーター/コンバーター/トランス

### 基板仕様 PWB Specification

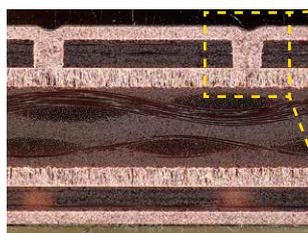
基板仕様	内層導体厚	層構成	板厚	最小導体幅	最小導体間隔	層間厚
厚銅貫通	量産中 175 $\mu\text{m}$	~6層	~3.0mm	400 $\mu\text{m}$	400 $\mu\text{m}$	300~350 $\mu\text{m}$
	R&D 210 $\mu\text{m}$	~6層	~3.0mm	450 $\mu\text{m}$	450 $\mu\text{m}$	300~350 $\mu\text{m}$
	R&D 300 $\mu\text{m}$	~6層	~3.0mm	600 $\mu\text{m}$	600 $\mu\text{m}$	350~450 $\mu\text{m}$
	R&D 500 $\mu\text{m}$	~6層	~3.0mm	1000 $\mu\text{m}$	1000 $\mu\text{m}$	350~450 $\mu\text{m}$
基板仕様	内層導体厚	層構成	板厚	LVH径	めっき厚	層間厚
厚銅ビルド	R&D 105 $\mu\text{m}$	~6層	~3.0mm	150 $\mu\text{m}$	60 $\mu\text{m}$	110 $\mu\text{m}$



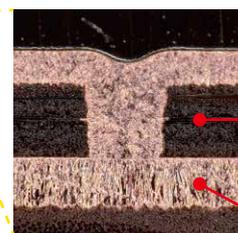
量産中 充電設備/6層貫通 内層175 $\mu\text{m}$   
 広州工場にて6層貫通基板(内層175 $\mu\text{m}$ )の量産実績あり



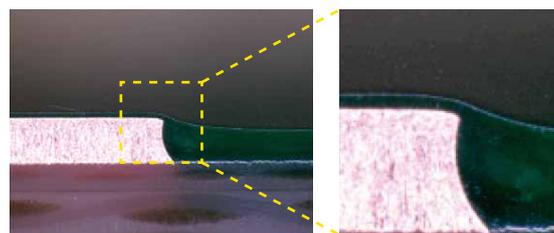
R&D 内層210 $\mu\text{m}$ 以上  
 絶縁層形成に樹脂シートを使用することで、  
 絶縁信頼性向上、薄板化、軽量化が可能。



R&D 厚銅ビルド基板 内層105 $\mu\text{m}$   
 厚銅回路の高密度化。  
 制御系と電源系の基板一体化が可能。



絶縁層:  
110 $\mu\text{m}$   
 内層導体厚  
105 $\mu\text{m}$



R&D 外層超厚銅(210 $\mu\text{m}$ 以上)対応  
 外層厚銅(210 $\mu\text{m}$ )対応したSR塗布工法により  
 大電流化が可能。